

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-002

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称/人员姓名	长城证券、东方财富证券、巨象私募基金、瀚鑫基金、德润鹏远基金、殷实基金、汉方私募基金、光影资管、必达控股、前海宏惟创世资本、融中资本、渤海银行、浙商银行及个人投资者
时间	2026 年 1 月 21 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p><b>Q1、公司大股东减持与本次定增时间较近，减持目的是什么？定增对象是否已确定？</b></p> <p>公司实际控制人及一致行动人于 2025 年 9 月 10 日披露减持计划，并于 2026 年 1 月 6 日完成减持。该过程严格履行了信息披露义务，其减持行为符合相关监管规定。</p> <p>自公司上市以来，实际控制人及一致行动人持股比例一直较高，本次减持后仍持有公司 51.71%的股份，保持绝对控股地位。大股东减持主要系其个人资金需求，属于正常的市场行为。从长远看，大股东减持也有助于进一步优化公司股权结构。</p> <p>公司本次向特定对象发行股票为公司基于液冷散热系统产业化及半导体封装材料扩产等业务发展的需要而适时推进的融资计划，本次向</p>

特定对象发行股票事项已于近期披露预案，目前正处于早期阶段，尚未确定具体发行对象。公司核心管理层战略清晰、团队稳定，大股东与全体投资者利益高度一致，未来将继续聚焦主营业务发展与新业务落地，全力提升公司核心竞争力与长期投资价值。

**Q2、国内液冷业务的竞争格局如何？公司是否借鉴了同行模式？行业壁垒如何？公司的竞争优势？**

答：1、国内液冷市场参与者包括系统集成商与核心零部件制造商，多类型主体共同参与。整体看，市场正从“项目制交付”向“标准化产品、平台化能力”演进，客户对可靠性、一致性、交付能力与成本控制的要求持续提高。

2、公司商业模式与部分同业类似，但根据市场分层采取差异化策略，公司液冷业务同时面向海外与国内两大市场：在海外市场，公司主要为客户提供液冷核心零部件，重点在工艺、制造能力与质量体系，强调规模化交付和成本控制；在国内市场，公司以系统级液冷解决方案为方向，面向国内客户提供从部件到系统的整体方案与交付服务能力。

3、液冷散热行业壁垒主要体现在客户验证周期长、导入门槛高、对供应链协同要求高等方面，核心部件对精密制造、钎焊、密封、清洁度控制、测试一致性等要求高，工艺爬坡具有显著门槛。

4、公司以半导体封装材料领域长期积累的工艺为基础，实现了从底层技术到系统解决方案的自然延伸，具备更强的工艺理解、制造稳定性与成本控制能力。在冷板、管路等核心部件方面形成了面向规模化交付的工艺与制造能力沉淀。公司竞争优势也体现在与全球技术前沿的深度绑定，目前公司已通过台湾合作伙伴进入美系头部半导体公司供应链，在技术理解、工艺储备与迭代节奏上保持与全球前沿同步，从而形成更强的持续竞争力。

**Q3、公司液冷零部件的毛利率水平如何？**

答：目前公司液冷业务尚处于小批量订单交付阶段，当前的毛利率水平受制于初期生产规模，暂不能客观反映规模化的盈利能力。公司液

	<p>冷散热产品运用自主研发的高性能生产工艺，与传统工艺相比，其制造成本更低，生产效率更高。预计随着订单量的规模突破，毛利率有望得到实质性优化。</p> <p><b>Q4、公司如何从智能卡业务延伸至液冷赛道？人才储备是否充足？本次募投资金是否足够？液冷产能爬坡计划及量产时间？</b></p> <p>答：公司自 2019 年投资宁波澄天专用芯片的封装项目后，逐步切入功率半导体封装材料领域，并基于在高导热金属材料、蚀刻、电镀、钎焊等工艺方面的积累，自然延伸至液冷散热赛道。公司目前已组建了具备工艺开发与客户服务能力的专业团队，其中负责人拥有多年行业经验，公司已在惠州建立了研发与初步产线，人才储备能够支持业务发展。</p> <p>公司本次募投项目资金是基于业务发展规划审慎确定，能够支持后续研发与产能建设需求。当前产能可满足初期订单需求，后续计划结合客户量产节奏，稳步推进液冷板产品的规模化交付，具体产能爬坡及量产时间将按计划逐步落实。</p> <p><b>Q5、公司加大在新赛道的投入是否会影响传统智能卡业务的技术迭代？</b></p> <p>答：智能卡业务正从实体卡向eSIM等形态演进，其本身技术已相对成熟。公司会继续推动智能卡业务与服务结合，提升盈利水平，同时将研发资源更聚焦于半导体封装材料和液冷散热等新业务。</p> <p><b>Q6、原材料价格上涨对净利润的影响及应对措施？</b></p> <p>答：公司主要原材料包括铜、金、银等金属，其价格上涨会对成本构成压力。公司已与客户建立价格联动机制，共同应对成本波动，同时公司严格落实成本优化策略，致力于减少生产过程中的损耗、提高生产效率，通过多维度的措施来缓解金属价上涨的压力，并尽可能地减少其对利润的不利影响。</p> <p><b>Q7、液冷业务未来收入贡献展望？公司在产业链中的定位与优势？</b></p> <p>答：液冷市场规模较大，虽然目前公司这块营收占比较低，但随客户量产导入，预计快速增长，有望成为重要收入来源。公司已通过台湾</p>
--	--

	<p>客户进入海外供应链，并为国内头部服务器厂商提供解决方案。公司优势在于具备从材料、零部件到系统设计的全链条能力，以及快速响应客户需求的敏捷服务能力。</p> <p><b>Q8、液冷业务在海外市场的商业模式如何？</b></p> <p>答：在海外市场，公司主要通过台湾合作伙伴进入北美供应链，此外，公司与AI基础设施解决方案提供商SuperX在新加坡设立了合资公司，核心战略在于整合各方优势，共同开拓全球AIDC机柜液冷产品市场，并以此拓展公司的海外销售渠道。</p> <p><b>Q9、公司液冷业务的零部件自供能力如何？</b></p> <p>答：公司具备从冷板、管路、Manifold到液冷模组组件开发和生产能力，但目前在CDU等涉及电气控制的环节会与合作伙伴协同完成。</p> <p><b>Q10、液冷技术是否会因芯片功耗下降而被替代？</b></p> <p>答：目前芯片功耗仍呈上升趋势，液冷散热需求持续增强。公司紧跟客户需求技术迭代，积极布局MLCP等下一代液冷技术。</p> <p><b>Q11、公司与SuperX合资公司的合作进展？</b></p> <p>答：为深化在数据中心先进散热领域的布局，公司于2025年10月与AI基础设施解决方案提供商SuperX共同出资设立了合资公司，其中公司通过全资子公司香港澄天以自有资金出资，持有合资公司25%的股权，公司主要向合资公司提供自主研发生产的液冷模组及关键部件，由SuperX进行系统集成后，共同推向市场，最终销售给下游云计算服务器厂商。目前合资公司尚处于业务拓展阶段。</p> <p><b>Q12、当前公司股价及市盈率较高，如何吸引投资者参与定增？</b></p> <p>答：公司理解投资者对当前估值水平的关注。截至目前智能卡业务仍为公司主要收入来源，公司当前市盈率水平，主要反映的是以智能卡业务为主的历史收入结构与传统业务特征，而尚未充分体现液冷与半导体封装材料业务这两大高成长业务的未来潜力。</p> <p>本次定增的核心吸引力，来自于公司通过募集资金加速新业务从验证导入走向规模化交付，从而提升未来业绩的可见度与结构质量，具体体现在：</p>
--	---

	<p>（1）补齐关键能力与产能配套：围绕核心工艺、测试验证、产线与交付体系建设，提高规模化交付能力与一致性；</p> <p>（2）提升客户导入效率与项目兑现能力：缩短验证到量产周期，增强对头部客户/重点项目的响应与保障；</p> <p>（3）优化业务结构与长期稳定性：推动收入结构从单一传统业务向“传统业务稳底盘 + 新业务增量”的方向演进，提升长期成长空间。公司相信，随着新业务在订单、验证、交付与盈利能力上逐步体现，市场对公司的定价将更充分反映未来业务结构与长期价值，从而为参与本次定增的投资者带来中长期回报机会。</p>
风险提示	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2026-1-21